

天津金海通半导体设备股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于 2026 年 1 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。为保障决议事项如期进行，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，会议通知已于 2026 年 1 月 16 日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 6 人）。

会议由董事长崔学峰召集并主持，部分高级管理人员列席。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

结合公司财务状况及自有资金余额情况，为了提高公司资金使用效率，增加公司自有资金收益，为公司和全体股东谋取更多的投资回报，在保障公司正常经营资金周转需要、有效控制投资风险的情况下，公司及下属公司（包括纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟使用合计不超过人民币 12 亿元（含美元、林吉特或其他等值货币）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行理财、券商收益凭证等理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用），实现公司自有资金的保值增值。

在经合法批准并授权后，公司股东会将授权总经理在有效期及额度范围内进行该项投资的具体决策并签署相关文件，包括但不限于选择合格专业的金融机构作为受托方、明确委托理财金额及期限、选择委托理财产品品种、签署协议等，授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月。公司财务部负责具体执行。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-007）。

本议案审议通过后，尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司发展计划和战略实施的需要，公司及下属公司（包括纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟向银行等金融机构申请合计总额不超过等值人民币 6 亿元（含 6 亿元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、林吉特等）的综合授信额度（最终以实际审批的授信额度为准）。上述额度在授权期限内可以循环使用，公司及下属公司无需就单笔授信或借款等相关事宜另行召开董事会。董事会授权总经理代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、承兑汇票、保函、信用证、贸易融资、固定资产项目贷款等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行等金融机构。授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月。

公司及下属公司可以不动产、动产或权益向银行、担保公司等金融机构为公司上述申请银行综合授信额度等相关事项提供担保，具体担保、反担保的金额、方式以公司与银行、担保公司等金融机构最终协商签订的担保协议为准。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-008）。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 2 月 5 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议如下议案：

序号	审议事项
1	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-009）。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日